



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 60  
行间距: 1.35 mm [ .053 in ]  
接合对准: 带有  
接合对准类型: 极化  
行数: 6

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 信号排列      | 差分       |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器系统     | 板对板      |
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 护罩种类      | 部分带罩     |

结构特性

|          |     |
|----------|-----|
| 线对数量     | 20  |
| 接地位置数量   | 20  |
| 信号位置数量   | 40  |
| 可堆叠      | 否   |
| 位数       | 60  |
| 行数       | 6   |
| 列数       | 10  |
| PCB 安装方向 | 垂直  |
| 引导位置     | 无引导 |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 30 VDC |
| 阻抗   | 100 Ω  |



信号特征

|          |              |
|----------|--------------|
| 数据速率     | 20 – 25 Gb/s |
| 每列的差分对数量 | 2            |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 端子底板材料             | 镍                          |
| 端子底板材料厚度           | 1.27 μm[50 μin]            |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光                         |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .76 μm[29.92 μin]          |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | .76 – 1.52 μm[30 – 60 μin] |
| 端子形状和构造            | 双梁                         |
| 端子布局               | 直插式                        |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)                     |
| 端子接触部长度            | 5.5 mm[.217 in]            |
| 端子基材               | 铜合金                        |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                          |
| 端子类型               | 插针                         |
| 端子额定电流（最大值）        | .75 A                      |

端接特性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| PCB 端接方法   | 通孔 - 免焊连接       |
| 端接柱体和尾部长度的 | 1.4 mm[.055 in] |

机械附件

|            |           |
|------------|-----------|
| 导轨硬件       | 不带        |
| PCB 安装固定   | 带有        |
| 接合固定       | 不带        |
| PCB 安装固定类型 | 作用/符合标准的尾 |
| 接合对准       | 带有        |
| 接合对准类型     | 极化        |
| 连接器安装类型    | 板安装       |

壳体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 有带罩的边数 | 3 - 侧面 |
|--------|--------|



|         |                 |
|---------|-----------------|
| 端壁位置    | 右               |
| 外壳材料    | LCP GF          |
| 中心线（间距） | 1.9 mm[.075 in] |

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| PCB 厚度（建议） | 1 mm             |
| 连接器宽度      | 12.7 mm[.5 in]   |
| PCB 孔直径    | .39 mm[.015 in]  |
| 连接器高度      | 11.95 mm[.47 in] |
| 连接器长度      | 20.3 mm[.799 in] |
| 行间距        | 1.35 mm[.053 in] |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|             |           |
|-------------|-----------|
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0  |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Tube, 盒和管 |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |





产品合规免责声明

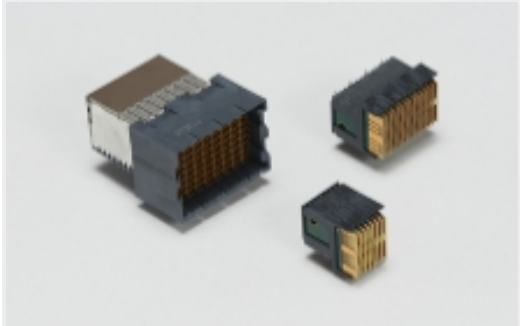
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2057405-1  
IMP100S,R,RA2P10C,UG,39

该系列中的其他产品 | IMPACT



高速背板连接器(149)

客户还购买了



TE 产品编号2057405-1  
IMP100S,R,RA2P10C,UG,39



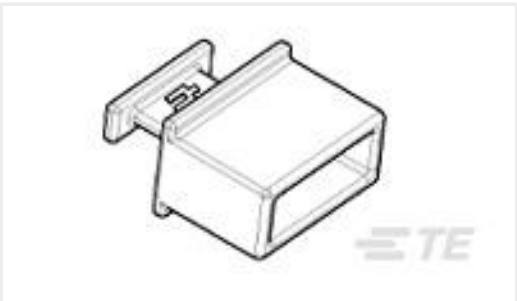
TE 产品编号2-2170703-6  
CAGE ASSEMBLY, QSFP28 1X1, SPRING



TE 产品编号2187308-1  
Tin Man Recept Assy 4 Pair 16 Column



TE 产品编号2321666-1  
ZQSFP+ STACKED REC ASSEMBLY 2X1



TE 产品编号1888810-2  
EMI/Dust Cover,XFP And QSFP



TE 产品编号2007215-2  
SFP+ 1x1 Cage Assy, PCI, Press Fit



TE 产品编号1761394-1  
DUST COVER, SFP, GANGED & STACKED



TE 产品编号6368062-8  
2X4 OFFSET STK MJ,SHLD,W/LED



TE 产品编号2170703-6  
CAGE ASSEMBLY, QSFP28 1X1, SPRING



TE 产品编号1367073-1  
20 POS SMT CONN, SFP, 15AU

文档

产品图纸

IMP100S,H,V2P10C,UG,REW39,5.5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本